

29.09.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

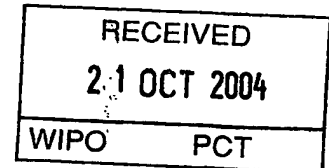
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 2 月 5 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 4 0 7 9 6 5
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 4 0 7 9 6 5]

出 願 人 パイオニア株式会社
Applicant(s):

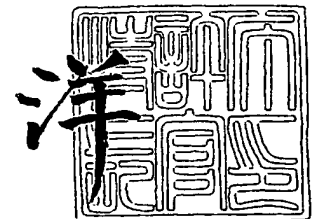


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 8 月 3 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願
【整理番号】 58P0431
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01S 5/40
H01L 33/00

【発明者】
【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見 6 丁目 1 番 1 号 パイオニア株式会社 総
合研究所内
【氏名】 宮地 護

【発明者】
【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見 6 丁目 1 番 1 号 パイオニア株式会社 総
合研究所内
【氏名】 木村 義則

【発明者】
【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見 6 丁目 1 番 1 号 パイオニア株式会社 総
合研究所内
【氏名】 竹間 清文

【特許出願人】
【識別番号】 000005016
【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【代理人】
【識別番号】 100063565
【弁理士】
【氏名又は名称】 小橋 信淳

【選任した代理人】
【識別番号】 100118898
【弁理士】
【氏名又は名称】 小橋 立昌

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 011659
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

波長の異なる複数のレーザ光を放射する半導体レーザ装置の製造方法であって、
半導体基板上に、第 1 のレーザ発振部を形成するための半導体を有する第 1 の多層体を形成するステップを含む、第 1 の中間生成体を作製する第 1 の工程と、
支持基板上に、第 2 のレーザ発振部を形成するための半導体から成る第 2 の多層体を形成するステップと、前記第 2 の多層体に溝を形成するステップとを含む、第 2 の中間生成体を作製する第 2 の工程と、
前記第 1 の中間生成体の前記第 1 の多層体側の面と前記第 2 の中間生成体の前記第 2 の多層体側の面を、導電性の接着層を介して固着することにより貼合体を作製する第 3 の工程と、
前記貼合体の前記支持基板側から前記第 2 の多層体に光を照射して、前記支持基板と前記第 2 の多層体を分離する第 4 の工程と、を有することを特徴とする半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 2】

前記光は、前記支持基板を透過し、前記支持基板との界面近傍の前記第 2 の多層体で吸収される光であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 3】

波長の異なる複数のレーザ光を放射する半導体レーザ装置の製造方法であって、
半導体基板上に、第 1 のレーザ発振部を形成するための半導体を有する第 1 の多層体を形成するステップを含む、第 1 の中間生成体を作製する第 1 の工程と、
支持基板上に、少なくとも光吸収層を含む層を形成するステップと、前記光吸収層上に第 2 のレーザ発振部を形成するための半導体から成る第 2 の多層体を形成するステップと、前記第 2 の多層体に溝を形成するステップとを含む、第 2 の中間生成体を作製する第 2 の工程と、
前記第 1 の中間生成体の前記第 1 の多層体側の面と前記第 2 の中間生成体の前記第 2 の多層体側の面を、導電性の接着層を介して固着することにより貼合体を作製する第 3 の工程と、
前記貼合体の前記支持基板側から前記光吸収層に光を照射することによって前記光吸収層を分解し、前記分解した光吸収層に沿って少なくとも前記支持基板を剥離する第 4 の工程と、を有することを特徴とする半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 4】

前記第 2 の工程において、前記溝を前記第 2 の多層体の表面から前記光吸収層までの深さよりも深く形成することを特徴とする請求項 3 に記載の半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 5】

前記光は、前記支持基板を透過し、前記光吸収層で吸収される光であることを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 6】

前記第 1 の工程又は前記第 2 の工程の少なくとも一方は、前記第 1 の中間生成体の前記第 1 の多層体側の面又は前記第 2 の中間生成体の前記第 2 の多層体側の面の少なくとも一方に前記接着層を形成する工程を含むことを特徴とする請求項 1 ～ 5 の何れか 1 項に記載の半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 7】

前記第 1 の多層体は、V 族元素として砒素 (As)、リン (P)、アンチモン (Sb) の何れかを含む III-V 族化合物半導体、又は II-VI 族化合物半導体を有し、
前記第 2 の多層体は、V 族元素が窒素 (N) から成る窒化物系 III-V 族化合物半導体を有することを特徴とする請求項 1 ～ 6 の何れか 1 項に記載の半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 8】

前記接着層は、金属であることを特徴とする請求項 1 ～ 7 の何れか 1 項に記載の半導体レ

ーザ装置の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】半導体レーザ装置の製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、波長の異なる複数のレーザ光を放射する半導体レーザ装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

デジタル放送やブロードバンドの普及により、大量のデジタルコンテンツが家庭等に溢れる時代を目前に控え、さらなる情報記録の高密度化が求められている。光ディスクストレージシステムにおいては、波長780nmの光を用いた容量700MBのCD (Compact Disc) から波長650nmの光を用いた容量4.7GBのDVD (Digital Versatile Disc) へと高密度化が進められてきた。さらに最近になり、容量20GBを超える光ディスクシステムが波長405nmの光を用いて実現されている。

【0003】

このような高密度記録システムにおいても、これまでに広く普及したDVDに対してコンパクトビリティを持たせる必要があるため、ピックアップには波長650nmのレーザも併せて搭載する必要がある。

【0004】

複数の波長に対応したピックアップでは、その小型化、軽量化のために2波長集積レーザが望まれているが、波長405nm帯のレーザを実現するGaN系半導体と波長650nm帯のレーザを実現するAlGaInP系半導体では物性が大きく異なるため、同一基板上へのモノリシック集積を行うことができない。そのため、ハイブリッド構造による2波長集積レーザが提案されている(特許文献1、特許文献2、特許文献3)。

【0005】

特許文献1の2波長集積レーザは、第1の基板を有する短波長(例えば、波長405nm帯)のレーザ光を放射する第1の発光素子と、第2の基板を有する長波長(例えば、波長650nm帯)のレーザ光を放射する第2の発光素子を支持基板(いわゆるサブマウント)上に重ねて取り付けることで、ハイブリッド構造の半導体レーザ装置が実現されている。

【0006】

ここで、第1の発光素子は、第1の基板の支持基板側に発光部が位置するように支持基板上に取り付けられており、更に第2の発光素子は、第2の基板の第1の発光素子側に発光部が位置するように第1の発光素子上に取り付けられている。

【0007】

特許文献2に開示されているハイブリッド構造の半導体レーザ装置は、第1のレーザ部のp電極とn電極に、第2のレーザ部のn電極とp電極を夫々融着金属を介して電気的に貼り合わせた後、第1のレーザ部側の基板を除去した構造とすることによって、第1のレーザ部と第2のレーザ部とで波長の異なるレーザ光を放射するようにしている。

【0008】

特許文献3に開示されているハイブリッド構造の半導体レーザ装置は、第1の半導体発光素子と第2の半導体発光素子を直接貼り合わせることで、ハイブリッド構造の半導体レーザ装置が実現されている。ここで、この貼り合わせ面側から電流を供給するために、一方の半導体発光素子を部分的にエッチングすることによってコンタクト層を露出させ、該コンタクト層から電流を注入するようにしている。

【0009】

【特許文献1】特開2001-230502号公報

【特許文献2】特開2000-252593号公報

【特許文献3】特開2002-118331号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

ところで、特許文献1の半導体レーザ装置は、上述したように、支持基板上に第1の発光素子と第2の発光素子を重ねて取り付ける構造となっているが、この構造の場合に第1の発光素子と第2の発光素子の重ね合わせ面への電流注入を可能とするためには、それぞれを個別の半導体チップとして製造した後、チップ化された第1の発光素子と第2の発光素子を支持基板上に重ねて取り付けることが必須となる。2波長集積レーザを光ディスクのピックアップ用光源として用いる場合には、その2つの発光点間隔を高精度（ $\pm 1\mu\text{m}$ 以下）で制御する必要があるが、チップの状態での位置合わせでは、発光点間隔や放射方向を高精度に制御することは困難である。また全てのチップ毎に位置合わせを行う必要があるため生産性も悪くなる。

【0011】

また、特許文献1の半導体レーザ装置は、支持基板上に第1の発光素子の発光部が近接して取り付けられ、第1の発光素子に備えられている第1の基板上に、第2の発光素子の発光部が近接して取り付けられている。

【0012】

しかし、この構造によると、第1の発光素子と第2の発光素子との間に、厚さの大きな第1の基板が存在することとなり、上述の特許文献1にも記載されているように、その第1の基板（Ga_{0.5}N_{0.5}基板）は通常100 μm 程度の厚さを有しているため、第1の発光素子の発光部（発光点の位置）と第2の発光素子の発光部（発光点の位置）とが大きく離れてしまうという問題がある。

【0013】

このため、例えば、ピックアップにこの半導体レーザ装置を搭載して、情報記録又は情報再生を行う場合、ピックアップを構成している光学系の光軸に対して第1の発光部の放射位置（発光点の位置）を光軸合わせすると、第2の発光部の放射位置が光学系の光軸から大きくずれることとなり、収差等の発生原因となってしまふ。

【0014】

このような光軸ずれによる悪影響は、光ピックアップにプリズム等の光学素子を追加することにより解消することができるが、部品点数、コストの増加等の問題が生じる。

【0015】

特許文献2の半導体レーザ装置では、第1のレーザ部のp、n電極と第2のレーザ部のn、p電極とが融着金属を介してそれぞれ電気的に接続されているため、第1のレーザ部を発光させるべく、融着金属を通じて第1のレーザ部に対し順方向に駆動電力を供給すると、第2のレーザ部は逆バイアスの状態、第2のレーザ部を発光させるべく、融着金属を通じて第2のレーザ部に対し順方向に駆動電力を供給すると、第1のレーザ部は逆バイアスの状態となる。

【0016】

このため、第1のレーザ部又は第2のレーザ部の一方を発光させると、他方のレーザ部に逆バイアスがかかり、逆方向耐圧や逆方向リーク電流の問題が生じる。

【0017】

特許文献3の半導体レーザ装置では、第1の半導体発光素子と第2の半導体発光素子とを直接貼り合わせるにより、2つの半導体レーザの集積を行うため、少なくともどちらか一方が、表面に凹凸を有する半導体発光素子（例えばリッジストライプ型半導体レーザ）の場合には、発光点に近い側の面同士を貼り合わせることができず、発光点間隔を小さくすることができない。また、特許文献3の半導体レーザ装置では、2つのレーザウェハを貼り合わせた後にAlGaInP系レーザ側をGaAs基板も含めて部分的にエッチングしてGaAsコンタクト層を露出させるが、エッチング前の状態でコンタクト層直上に位置する電流狭窄層もGaAsであるため、GaAsコンタクト層でエッチングをストップさせるのは非常に困難である。さらに、貼り合わせ面側から電流を供給するには、コンタクト層に面内方向から電流を流す必要があるが、コンタクト層はGaAs等の半導体

で構成されるため、電流の流入経路における電気抵抗が大きくなるという問題がある。

【0018】

本発明はこのような従来の課題に鑑みてなされたものであり、波長の異なる複数のレーザ光を放射すると共に、発光点間隔が小さく、電気的特性に優れ且つ機械的精度の高い半導体レーザ装置の製造方法を提供することを目的とする。

【0019】

また、波長の異なる複数のレーザ光を放射すると共に、発光点間隔が小さく、電気的特性に優れ且つ機械的精度の高い半導体レーザ装置を量産性良く製造するための製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0020】

上記目的を達成するための請求項1に記載の発明は、波長の異なる複数のレーザ光を放射する半導体レーザ装置の製造方法であって、半導体基板上に、第1のレーザ発振部を形成するための半導体を有する第1の多層体を形成するステップを含む、第1の中間生成体を作製する第1の工程と、支持基板上に、第2のレーザ発振部を形成するための半導体から成る第2の多層体を形成するステップと、前記第2の多層体に溝を形成するステップとを含む、第2の中間生成体を作製する第2の工程と、前記第1の中間生成体の前記第1の多層体側の面と前記第2の中間生成体の前記第2の多層体側の面を、導電性の接着層を介して固着することにより貼合体を作製する第3の工程と、前記貼合体の前記支持基板側から前記第2の多層体に光を照射して、前記支持基板と前記第2の多層体を分離する第4の工程と、を有することを特徴とする。

【0021】

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の半導体レーザ装置の製造方法であって、前記光は、前記支持基板を透過し、前記支持基板との界面近傍の前記第2の多層体で吸収される光であることを特徴とする。

【0022】

請求項3に記載の発明は、波長の異なる複数のレーザ光を放射する半導体レーザ装置の製造方法であって、半導体基板上に、第1のレーザ発振部を形成するための半導体を有する第1の多層体を形成するステップを含む、第1の中間生成体を作製する第1の工程と、支持基板上に、少なくとも光吸収層を含む層を形成するステップと、前記光吸収層上に第2のレーザ発振部を形成するための半導体から成る第2の多層体を形成するステップと、前記第2の多層体に溝を形成するステップとを含む、第2の中間生成体を作製する第2の工程と、前記第1の中間生成体の前記第1の多層体側の面と前記第2の中間生成体の前記第2の多層体側の面を、導電性の接着層を介して固着することにより貼合体を作製する第3の工程と、前記貼合体の前記支持基板側から前記光吸収層に光を照射することによって前記光吸収層を分解し、前記分解した光吸収層に沿って少なくとも前記支持基板を剥離する第4の工程と、を有することを特徴とする。

【0023】

請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の半導体レーザ装置の製造方法であって、前記第2の工程において、前記溝を前記第2の多層体の表面から前記光吸収層までの深さよりも深く形成することを特徴とする。

【0024】

請求項5に記載の発明は、請求項3又は4に記載の半導体レーザ装置の製造方法であって、前記光は、前記支持基板を透過し、前記光吸収層で吸収される光であることを特徴とする。

【0025】

請求項6に記載の発明は、請求項1～5の何れか1項に記載の半導体レーザ装置の製造方法であって、前記第1の工程又は前記第2の工程の少なくとも一方は、前記第1の中間生成体の前記第1の多層体側の面又は前記第2の中間生成体の前記第2の多層体側の面の少なくとも一方に前記接着層を形成する工程を含むことを特徴とする。

【0026】

請求項7に記載の発明は、請求項1～6の何れか1項に記載の半導体レーザ装置の製造方法であって、前記第1の多層体は、V族元素として砒素(As)、リン(P)、アンチモン(Sb)の何れかを含むIII-V族化合物半導体、又はII-VI族化合物半導体を有し、前記第2の多層体は、V族元素が窒素(N)から成る窒化物系III-V族化合物半導体を有することを特徴とする。

【0027】

請求項8に記載の発明は、請求項1～7の何れか1項に記載の半導体レーザ装置の製造方法であって、前記接着層は、金属であることを特徴とする。

【発明を実施するための最良の形態】

【0028】

以下、発明を実施するための最良の形態として、第1、第2の実施形態について図面を参照して説明する。

【0029】

〔第1の実施形態〕

第1の実施形態を図1及び図2を参照して説明する。図1は、本実施形態の製造方法により作製される半導体レーザ装置の外部構造を表した斜視図、図2は、本実施形態の半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

【0030】

図1において、本実施形態により作製される半導体レーザ装置LDは、波長の異なるレーザ光を放射する第1の発光素子1と第2の発光素子2とを備え、金属から成る接着層CNTの融着等によって、第1、第2の発光素子1、2が一体に固着されている。

【0031】

第1の発光素子1は、III-V族化合物半導体(例えばGaAs)から成る半導体基板SUB1と、半導体基板SUB1上に、III-V族化合物半導体またはII-VI族化合物半導体から成る第1の多層体によって形成された第1のレーザ発振部1aと、第1のレーザ発振部1aの半導体基板SUB1とは反対側の面に形成されたストライプ状の導波路1bと、導波路1b以外の領域を絶縁被覆する絶縁膜1cと、導波路1bに電気的に接続され且つ絶縁膜1c上の全面に形成されたオーミック電極層1dと、半導体基板SUB1の裏面に形成されたオーミック電極層P1とを有しており、第1のレーザ発振部1aから所定波長のレーザ光が放射される。

【0032】

第2の発光素子2は、V族元素が窒素(N)である窒化物系III-V族化合物半導体から成る第2の多層体によって形成された第2のレーザ発振部2aと、第2のレーザ発振部2aの接着層CNT側の面に形成されたストライプ状の導波路2bと、導波路2b以外の少なくとも接着層CNT側に面した領域を絶縁被覆する絶縁膜2cと、導波路2bに電気的に接続され且つ絶縁膜2cの接着層CNT側に面した領域に形成されたオーミック電極層2dと、第2のレーザ発振部2aの表面に形成されたオーミック電極層P2とを有しており、第2のレーザ発振部2aから所定波長のレーザ光が放射される。

【0033】

そして、後述の製造方法において説明するように、第1の発光素子1を形成するためのウェハ状の中間生成体100と、第2の発光素子2を形成するためのウェハ状の中間生成体200とを予め作製し、中間生成体100に形成したオーミック電極層1dと中間生成体200に形成したオーミック電極層2dとを接着層CNTによって固着することで、中間生成体100、200とが一体化した貼合体を作製した後、該貼合体に所定の加工を施して劈開することによって、第2の発光素子2の形成領域に比して第1の発光素子1の占有面積の方が大きく(別言すれば、第1の発光素子1に比して第2の発光素子2の方が小形で)、且つ接着層CNTが第1の発光素子1の全面に形成されることで、第2の発光素子2の形成領域以外の領域で露出し、該露出した接着層CNTがコモンアノードとして機能する構造を有する半導体レーザ装置LDが形成されている。

【0034】

更に、第1のレーザ発振部1aには、上記第1の多層体によってIII-V族化合物半導体またはII-VI族化合物半導体から成る歪量子井戸構造の活性層とその活性層を挟むようにして積層されたクラッド層とを有する二重ヘテロ構造(DH)が構成されており、更に導波路1bの長手方向の両側において第1のレーザ発振部1aを劈開することにより形成された劈開面によってレーザ共振器が構成されている。

【0035】

第2のレーザ発振部2aには、上記第2の多層体によって窒化物系III-V族化合物半導体から成る多重量子井戸構造の活性層とその活性層を挟むようにして積層されたクラッド層とを有する二重ヘテロ構造(DH)が構成されており、更に導波路2bの長手方向の両側において第2のレーザ発振部2aを劈開することにより形成された劈開面によってレーザ共振器が構成されている。

【0036】

かかる構造を有する半導体レーザ装置LDにおいて、接着層CNTの露出部Pcとオーミック電極層P1間に駆動電流を供給すると、その駆動電流が導波路1bを通じて第1のレーザ発振部1a中の上述の活性層に流入することで光が発生し、その光が上述のレーザ共振器内でキャリア再結合を誘起して誘導放出を行わせることにより、第1のレーザ発振部1aに形成されている劈開面から所定波長(例えば、650nm)のレーザ光が放射される。

【0037】

また、接着層CNTの露出部Pcとオーミック電極層P2間に駆動電流を供給すると、その駆動電流が導波路2bを通じて第2のレーザ発振部2a中の上述の活性層に流入することで光が発生し、その光が上述のレーザ共振器内でキャリア再結合を誘起して誘導放出を行わせることにより、第2のレーザ発振部2aに形成されている劈開面から所定波長(例えば、405nm)のレーザ光が放射される。

【0038】

次に、該半導体レーザ装置LDの製造方法を図2を参照して説明する。同図(a)は第1の中間生成体100、同図(b)は第2の中間生成体200の作製工程及び構造を夫々模式的に表した斜視図、同図(c)～同図(f)は中間生成体100、200によって半導体レーザ装置LDを製造する工程を模式的に表した斜視図である。また、図2(a)～(f)において、図1と同一又は相当する部分を同一符号で示している。

【0039】

図2(a)に示す第1の中間生成体100は、III-V族化合物半導体(例えば、GaAs)から成るウェハ状の半導体基板SUB1上に、III-V族化合物半導体又はII-VI族化合物半導体から成る二重ヘテロ構造を有する第1の多層体X1aを形成した後、ストライプ状の複数のリッジ導波路1bを所定のピッチ間隔で形成し、次に多層体X1aの導波路1b以外の領域を絶縁膜1cで絶縁被覆して、導波路1bに電気的に接続するオーミック電極層1dを絶縁膜1c上に形成し、更に金属から成る接着層CNT1を形成することによって作製されている。

【0040】

図2(b)に示す第2の中間生成体200は、支持基板SUB2としてのサファイア基板上に、窒化物系III-V族化合物半導体から成る二重ヘテロ構造を有する第2の多層体Y2aを形成した後、ストライプ状の複数のリッジ導波路2bを所定のピッチ間隔で形成し、次に多層体Y2aの各導波路2b間の所定領域を所定の深さまでエッチングすることで、複数の台部と溝Rとが隣接した構造を有する多層体Y2aに加工し、更に多層体Y2aの各導波路2b以外の領域を絶縁膜2cで被覆した後、導波路2bに電気的に接続するオーミック電極層2dと接着層CNT2とを順次形成することによって作製されている。

【0041】

更に、第1の中間生成体100のリッジ導波路1bのピッチ間隔と、第2の中間生成体200のリッジ導波路2bのピッチ間隔とが共に等しいピッチ間隔となっている。

【0042】

次に、図2(c)に示すように、第1、第2の中間生成体100、200に形成されているリッジ導波路1b、2bを対向させて接着層CNT1、CNT2を密着させ、密着した部分の接着層CNT1、CNT2同士を融着させることによって、図1に示した一体化した接着層CNTを形成することにより、中間生成体100、200とが一体化した貼合体を作製する。

【0043】

ここで、図2(b)に示すように多層体Y2aの導波路2bをリッジ構造の導波路で形成した場合、接着層CNT2の表面に凹凸が生じることとなるが、図2(c)に示すように接着層CNT1、CNT2を金属の融着によって貼り合わせるので、上述の凹凸の影響を受けることなく、導波路1b、2bを最適な間隔に近接させて位置合わせすることが可能である。

【0044】

次に、図2(d)に示すように、支持基板SUB2を透過する所定波長(例えば、360nm以下)のレーザー光を照射する。

【0045】

これにより、レーザー光は、支持基板SUB2中で殆ど吸収されずに透過し、多層体Y2aには僅かな浸透深さで吸収される。更に、支持基板SUB2と多層体Y2aの間に大きな格子不整合があることから、多層体Y2aにおいて支持基板SUB2に接合している部分(以下「接合部近傍の部分」という)には極めて多くの結晶欠陥が存在する。このため、多層体Y2aの接合部近傍の部分においてレーザー光は殆ど熱に変換され、その接合部近傍の部分が急激に高温加熱されて分解する。そして、予め溝Rが形成されているため、溝Rに面している多層体Y2aの薄い部分がガスの力を受けて崩落等し、複数の多層体Y2aが溝Rを境にして分割形成される。

【0046】

次に、貼合体を所定の温度で加熱することによって、分割形成された各多層体Y2aと支持基板SUB2との接合面の結合力を低下させ、その状態で支持基板SUB2を剥離することによって、各多層体Y2aの表面と、溝Rに面した接着層CNTを露出させる。

【0047】

次に、露出した各多層体Y2aの表面と接着層CNTの表面とを洗浄した後、図2(e)に示すように、半導体基板SUB1の裏面全体にオーミック電極層P1、各多層体Y2aの表面にオーミック電極層P2を夫々形成する。

【0048】

次に、図2(f)に示すように、第1、第2の中間生成体100、200全体を導波路1b、2bの長手方向に対して直交する方向に沿って劈開すると共に、導波路1b、2bの長手方向と平行な方向に溝Rの部分を劈開することによって、図1に示すような個々の半導体レーザー装置LDを完成している。

【0049】

以上説明したように本実施形態の製造方法及び該製造方法により作製される半導体レーザー装置LDによれば、接着層CNTによって、第1、第2の発光素子1、2を複数個形成することが可能な中間生成体100、200をいわゆるウェハの状態貼り合わせてから、劈開によって個々の半導体レーザー装置LDを完成するので、導波路1bと2bの高精度での位置決めと、第1、第2の発光素子1、2の発光点間隔の最適化制御とを1回の貼り合わせによって行うことができ、量産性の向上を図ることができる。

【0050】

また、接着層CNTに貼り合わされた第1、第2の発光素子1、2のオーミック電極層1d、2dは共にp側電極となることから、接着層CNTは、オーミック電極層1d、2dを通じて第1、第2のレーザー発振部1a、2aに順バイアスの駆動電流を供給するためのコモンアノードとして機能する。このため、例えば駆動用電流源と接着層CNTとの間に1個のスイッチング素子を接続するだけで、該スイッチング素子を介して第1、第2の

レーザ発振部1a, 2aに駆動電流を供給することが可能となる等、駆動回路の構成を簡素化することが可能となる。

【0051】

また、接着層CNTとオーミック電極層P1間にのみ駆動電流を供給すれば第1の発光素子1のみを発光させ、接着層CNTとオーミック電極層P2間にのみ駆動電流を供給すれば第2の発光素子2のみを発光させ、更にまた、接着層CNTとオーミック電極層P1間、及び接着層CNTとオーミック電極層P2間に同時に駆動電流を供給すると、第1, 第2の発光素子1, 2を同時に発光させることができるため、極めて多様な使用形態を提供することができる。

【0052】

また、特開2000-252593号公報に記載されている多波長型の半導体レーザでは、一方のレーザ素子を駆動すると他方のレーザ素子が逆バイアスとなるため、逆方向耐圧を考慮する必要上、大電流で駆動することができず、更に逆方向リーク電流も存在するため消費電力が大きくなるという問題があるが、本実施形態により作製される半導体レーザ装置LDでは、上述したように接着層CNTとオーミック電極層P1間、又は接着層CNTとオーミック電極層P2間に夫々独立に駆動電流を供給することで、第1, 第2の発光素子1, 2を独立に発光させることができる。このため、本実施形態により作製される半導体レーザ装置LDによれば、第1, 第2の発光素子1, 2を夫々大電流で駆動することができると共に、逆方向リーク電流の問題がないことから、消費電力を低減することができる。

【0053】

また、製造工程において、第1, 第2の中間生成体100, 200に形成した接着層CNT1, CNT2を貼り合わせることで一体化した接着層CNTを介して第1, 第2の中間生成体100, 200を一体に固着させるので、ストライプ状のリッジ構造を有する導波路1b, 2bを形成してオーミック電極層1d, 2dの夫々の表面に凹凸が生じて、導波路1b, 2bの対向間隔を狭くして容易に貼り付けることができる。このため、発光点間隔が非常に小さく且つ歩留りのよい半導体レーザ装置を実現することができる。

【0054】

また、製造工程において、図2(b)に示したように第2の中間生成体200側に予め溝Rを形成しておくので、図2(c)に示したように第1, 第2の中間生成体100, 200の接着層CNT1, CNT2を貼り合わせると、第1の中間生成体100側の接着層CNT1が溝Rに面して露出する。したがって、例えば上述の支持基板SUB2の剥離後に個々の半導体レーザ装置に何らかの加工処理を施さなくとも、支持基板SUB2を剥離するだけで接着層CNT1をコモンアノードとして容易に露出させることができ、製造工程の簡素化等を実現することが可能である。

【0055】

なお、以上に説明した本実施形態に係る半導体レーザ装置の製造方法では、第1の中間生成体100に接着層CNT1、第2の中間生成体200に接着層CNT2を形成し、接着層CNT1, CNT2を接着することによって、第1, 第2の中間生成体100, 200を固着することとしているが、この製造方法に限定されるものではなく、第1の中間生成体100又は第2の中間生成体200の何れか一方に接着層を形成しておき、当該接着層を介して第1の中間生成体100と第2の中間生成体200を固着するようにしてもよい。

【0056】

また、支持基板SUB2としてサファイア基板を用いた場合について説明したが、AlN基板、SiC基板、AlGaN基板を用いるようにしてもよい。

〔第2の実施形態〕

次に、第2の実施形態を図3を参照して説明する。図3は、本実施形態の製造方法を模式的に表した図であり、図2と同一又は相当する部分を同一符号で示している。

【0057】

本実施形態により作製される半導体レーザ装置は、基本的に図1に示した半導体レーザ装置と同じ構造を有している。ただし、次に述べるように製造方法が異なっている。

【0058】

すなわち、本製造方法を述べると、まず、図3(a)(b)に示す第1の中間生成体100と第2の中間生成体200を予め作製する。ここで、図3(a)に示す第1の中間生成体100は、図2(a)に示した中間生成体100と同じ構造に作製する。

【0059】

図3(b)に示す第2の中間生成体200については、図2(b)に示した中間生成体200とは異なり、支持基板SUB2と第2のレーザ発振部2aを形成するための多層体Y2aとの間に、後述の支持基板SUB2を剥離する際に照射されるレーザ光を吸収する光吸収層STPが予め形成されている。

【0060】

より具体的には、図3(b)において、支持基板SUB2上に例えばn型GaN等から成る下地層2abと、例えばInGaN等から成る光吸収層STPとを積層し、その光吸収層STP上に、窒化物系III-V族化合物半導体から成る二重ヘテロ構造を有する多層体Y2aを形成し、多層体Y2aにストライプ状の複数の導波路2bを第1の中間生成体100の導波路1bと同じピッチ間隔で形成する。次に、多層体Y2aの各導波路2b間の所定領域を少なくとも下地層2abに到達する深さまでエッチングすることによって複数の溝Rを形成すると共に、多層体Y2aを複数個に分割する。次に、導波路2b以外の表面領域に絶縁膜2cを形成した後、導波路2b及び絶縁膜2cの表面全体にオーミック電極層2dを形成することによって、オーミック電極2dと導波路2bとを電気的に接続させ、更にオーミック電極層2d上に接着層CNT2を形成することによって、図3(b)に示す第2の中間生成体200を作製する。

【0061】

次に、図3(c)に示すように、第1、第2の中間生成体100、200に形成されている導波路1b、2bを対向させて接着層CNT1、CNT2を密着させ、密着した部分の接着層CNT1、CNT2同士を融着させて一体化した接着層CNTを形成することによって、第1、第2の中間生成体100、200を一体に固着した貼合体を作製する。

【0062】

次に、図3(d)に示すように、支持基板SUB2と下地層2abを透過する所定波長のレーザ光を支持基板SUB2の裏面側から照射する。これにより、レーザ光は支持基板SUB2と下地層2ab中を透過して光吸収層STPに到達し、レーザ光によって光吸収層STPが加熱分解されることにより、下地層2abと第2のレーザ発振部2a間の結合力が低下する。

【0063】

そこで、光吸収層STPを境にして多層体Y2aから支持基板SUB2を剥離することにより、下地層2abと、溝Rに形成されている接着層CNT2とオーミック電極層2dと絶縁膜2cとを支持基板SUB2に付随させて取り除き、各多層体Y2aの表面と溝Rに面している接着層CNTとを露出させる。

【0064】

次に、図3(e)に示すように、半導体基板SUB1の裏面全体にオーミック電極層P1、各多層体Y2aの表面にオーミック電極層P2を夫々形成した後、図3(f)に示すように、第1、第2の中間生成体100、200全体を導波路1b、2bの長手方向に対して直交する方向に沿って劈開すると共に、導波路1b、2bの長手方向と平行な方向に溝Rの部分を劈開することにより、図1に示すような個々の半導体レーザ装置LDを完成させている。

【0065】

以上説明したように本実施形態の製造方法及び該製造方法により作製される半導体レーザ装置LDによれば、上述した第1の実施形態と同様の効果が得られる他、製造工程において、第2の中間生成体200側に予め光吸収層STPを形成しておき、支持基板SUB

2の裏面側から所定波長のレーザ光を照射して光吸収層STPを分解させるので、支持基板SUB2と共に下地層2abを除去することができる。

【0066】

これにより、多層体Y2aにおける活性層及びガイド層への光の閉じ込めが向上し、レーザ光の放射ビームの品質が向上する。

【0067】

また、支持基板SUB2の裏面側から照射するレーザ光には、下地層2abを透過するようなレーザ光を用いるため、支持基板SUB2は下地層2abと同一の材料、例えばGaNを用いることができる。このため、さらに高品質な多層体Y2aを形成することが可能となる。

【0068】

また、図3(b)に示した第2の中間生成体200に予め溝Rを形成する際、支持基板SUB2から光吸収層STPまでの厚みに較べて、支持基板SUB2から溝Rの底面までの厚みの方が小さくなるように、溝Rの深さを調整しておくこと、その溝Rによって薄くなった下地層2abの部分から光吸収層STPが予め取り除かれることとなる。このため、支持基板SUB2の裏面側からの所定波長のレーザ光の照射及び支持基板SUB2の剥離工程において、溝Rにおける下地層2abを破碎等することなく、溝Rに面している接着層CNT1を露出させることができるため、歩留まりの向上を図ることができる等の効果が得られる。

【0069】

なお、以上に説明した第2の実施形態に係る半導体レーザ装置の製造方法では、支持基板SUB2と光吸収層STPの間に下地層2abを形成しているが、下地層2abを形成せず、支持基板SUB2上に光吸収層STPを直接形成してもよい。かかる製造方法によっても、図1に示したものと同一構造の半導体レーザ装置を作製することが可能である。

【0070】

ただし、支持基板SUB2と光吸収層STPの間に下地層2abを形成すると、結晶欠陥の少ない高品質な多層体Y2aを形成することが可能となり、支持基板SUB2と光吸収層STPの間に下地層2abを形成することが望ましい。

【0071】

また、以上に説明した第2の実施形態に係る半導体レーザ装置の製造方法では、第1の中間生成体100に接着層CNT1、第2の中間生成体200に接着層CNT2を形成し、接着層CNT1、CNT2を接着することによって、第1、第2の中間生成体100、200とを固着した貼合体を作製することとしているが、この製造方法に限定されるものではなく、第1の中間生成体100又は第2の中間生成体200の何れか一方に接着層を形成しておき、当該接着層を介して第1の中間生成体100と第2の中間生成体200を固着するようにしてもよい。

【実施例1】

【0072】

次に、第1の実施形態に係るより具体的な実施例を図4～図7を参照して説明する。図4は、本実施例により作製される半導体レーザの構造を模式的に表した断面図、図5～図7は、本実施例の半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。また、図4～図7において、図1及び図2と同一又は相当する部分を同一符号で示している。

【0073】

図4において、本実施例により作製される半導体レーザ装置LDは、半導体基板SUB1上に形成された第1のレーザ発振部1aを有する第1の発光素子1と、第2のレーザ発振部2aを有する第2の発光素子2とを備え、第1、第2の発光素子2が融着金属（例えばSn）から成る接着層CNTによって一体に固着されている。

【0074】

第1のレーザ発振部1aは、III-V族化合物半導体（本実施例では、GaAs）から成る半導体基板SUB1上に積層された、n型バッファ層1aaと、n型クラッド層1abと、

n型ガイド層 1acと、歪量子井戸構造を有した活性層 1adと、p型ガイド層 1aeと、p型クラッド層 1afと、p型クラッド層 1afに形成されたリッジ導波路 1bの頂部に形成されたp型通電層 1agとp型コンタクト層 1ahを備えた構造となっている。

【0075】

また、p型コンタクト層 1ah以外のp型クラッド層 1afの領域に絶縁膜 1cが形成されると共に、p型コンタクト層 1ahに電氣的に接続するオーミック電極層 1dが絶縁膜 1c上に形成され、更に半導体基板 SUB1の裏面にオーミック電極層 P1が形成されている。

【0076】

第2のレーザ発振部 2aは、n型下地層 2abと、n型クラッド層 2acと、n型ガイド層 2adと、多重量子井戸構造を有する活性層 2aeと、電子障壁層 2afと、p型ガイド層 2agと、p型クラッド層 2ahと、p型クラッド層 2ahに形成された導波路 2bの頂部に形成されたp型コンタクト層 2aiとを備えた多層体によって形成されている。

【0077】

また、p型コンタクト層 2ai以外のp型クラッド層 2ahの領域に絶縁膜 2cが形成されると共に、p型コンタクト層 2aiに電氣的に接続するオーミック電極層 2dが絶縁膜 1c上に形成され、更にn型下地層 2abの表面にオーミック電極層 P2が形成されている。

【0078】

そして、第1のレーザ発振部 1a側のオーミック電極層 1dと第2のレーザ発振部 2a側のオーミック電極 2dが融着金属からなる接着層 CNTによって固着されることによって第1、第2の発光素子 1、2とが一体化されており、更に第2の発光素子 2の形成領域に比して第1の発光素子 1の占有面積の方が大きく、且つ接着層 CNTが第1の発光素子 1上の全面に形成されることで、第2の発光素子の形成領域以外の領域で露出し、該露出した接着層 CNTがコモンアノードとして機能する構造を有する半導体レーザ装置 LDが形成されている。

【0079】

次に、図5～図7を参照して、本半導体レーザ装置 LDの製造方法を説明する。なお、図5(a)は第1の中間生成体 100の作製工程を模式的に表した断面図、図5(b)～(d)は第2の中間生成体 200の作製工程を模式的に表した断面図、図6(a)～(c)と図7(a)(b)は、第1、第2の中間生成体 100、200から該半導体レーザ装置 LDを製造する工程を表した断面図と斜視図である。

【0080】

図5(a)に基づいて第1の中間生成体 100の作製工程を述べると、MOCVD法等により、ウェハ状のGaAs(001)基板から成る半導体基板 SUB1上に、珪素(Si)をドーピングしてn型化したn型GaAsから成るバッファ層 1aaを厚さ約0.5μmで積層し、次にn型Al_{0.35}Ga_{0.15}In_{0.5}Pから成るn型クラッド層 1abを厚さ約1.2μmで積層し、次にAlGaInPから成るガイド層 1acを厚さ0.05μmで積層し、次にGaInPとAlGaInPとから成る歪量子井戸構造を有した活性層 1adを約数十nmの厚さで積層し、次にAlGaInPから成るガイド層 1aeを厚さ0.05μmで積層し、次に亜鉛(Zn)をドーピングしてp型化したAl_{0.35}Ga_{0.15}In_{0.5}Pから成るp型クラッド層 1afを厚さ約1.2μmで積層し、次にp型Ga_{0.5}In_{0.49}Pから成るp型通電層 1agを厚さ約0.05μmで積層し、次にp型GaAsから成るp型コンタクト層 1ahを厚さ約0.2μmで積層することによって、AlGaInP系半導体から成る多層体 X1aを形成する。

【0081】

次に、導波路 1bを形成するための所定領域をマスクングして、p型コンタクト層 1ah側からウェットエッチングすることにより、p型クラッド層 1afが約0.2μm程度の厚さとなるまでエッチングし、AlGaInP系半導体から成る多層体 X1aに、〈110〉方向に沿ったストライプ状のリッジ構造を有する導波路 1bを複数形成する。

【0082】

次に、各導波路 1b 上に形成された p 型コンタクト層 1ah 以外の p 型クラッド層 1af の領域に、SiO₂ から成る絶縁膜 1c を形成した後、p 型コンタクト層 1ah と絶縁膜 1c の全面に、クロム (Cr) 又は金 (Au) 若しくはこれらの積層から成るオーミック電極層 1c を厚さ約 200 nm で形成することによって、p 型コンタクト層 1ah とオーミック電極層 1c とを電氣的に接続させ、次に、オーミック電極層 1c の全面に、融着金属として錫 (Sn) から成る接着層 CNT 1 を形成することによって、第 1 の中間生成体 100 を作製する。

【0083】

次に、図 5 (b) ~ (d) に基づいて第 2 の中間生成体 200 の作製工程を述べると、サファイア基板から成る支持基板 SUB 2 上に、MOCVD 法等により、組成と膜厚等の異なった GaN 系半導体より成る複数の半導体薄膜を積層することで、多重量子井戸構造の活性層とクラッド層とを有した GaN 系半導体から成る多層体 Y2a を形成する。

【0084】

より具体的には、サファイア (0001) 基板 SUB 2 上に、GaN 又は AlN から成る n 型バッファ層 2aa を厚さ約数十 nm 程度で積層し、次に珪素 (Si) をドーピングして n 型化した n 型 GaN から成る n 型下地層 2ab を厚さ約 5 ~ 15 μ m で積層し、次に n 型 Al_{0.08}Ga_{0.92}N から成る n 型クラッド層 2ac を厚さ約 0.8 μ m で積層し、次に n 型 GaN から成る n 型ガイド層 2ad を厚さ約 0.2 μ m で積層し、次に、組成の異なる In_xGa_{1-x}N (但し、0 ≤ x)、例えば In_{0.08}Ga_{0.92}N と In_{0.01}Ga_{0.99}N から成る井戸層とバリア層との多重量子井戸構造を有する活性層 2ae を約数十 nm の厚さで積層し、次に、Al_{0.2}Ga_{0.8}N から成る電子障壁層 2af を厚さ約 0.02 μ m で積層し、次に、マグネシウム (Mg) をドーピングして p 型化した p 型 GaN から成る p 型ガイド層 2ag を厚さ約 0.2 μ m で積層し、次に、p 型 Al_{0.08}Ga_{0.92}N から成る p 型クラッド層 2ah を厚さ約 0.4 μ m で積層し、次に p 型 GaN から成る p 型コンタクト層 2ai を厚さ約 0.1 μ m で形成することによって、GaN 系半導体から成る多層体 Y2a を形成する。

【0085】

次に、反応性イオンエッチング (RIE) によって、ストライプ状の導波路 2b を形成するための領域を除いて多層体 Y2a をエッチングし、p 型クラッド層 2ah が約 0.05 μ m 程度の厚さとなる深さまでエッチングすることによって、〈11-20〉方向に沿ったストライプ状のリッジ構造を有する導波路 2b を複数個形成する。

【0086】

次に、多層体 Y2a の各導波路 2b 間の所定領域を約 5 μ m の深さまでエッチングすることにより、図 5 (c) に示すような n 型下地層 2ab に達する溝 R を形成した後、p 型コンタクト層 2ai 以外の領域に SiO₂ から成る絶縁膜 2c を形成して絶縁被覆する。

【0087】

次に、図 5 (d) に示すように、p 型コンタクト層 2ai と絶縁膜 2c の全面に、パラジウム (Pd) 又は金 (Au) 若しくはこれらの積層から成るオーミック電極層 2d を厚さ約 200 nm で形成することによって、オーミック電極層 2d を p 型コンタクト層 2ah と電氣的に接続させ、次に、オーミック電極層 2d の全面に、融着金属として金 (Au) から成る接着層 CNT 2 を形成することによって、第 2 の中間生成体 200 を作製する。

【0088】

次に、図 6 及び図 7 に示す工程により、予め作製した中間生成体 100, 200 から本半導体レーザ装置 LD を製造する。

【0089】

まず、図 6 (a) に示すように、第 1, 第 2 の中間生成体 100, 200 に形成されている導波路 1b, 2b を対向させて接着層 CNT 1, CNT 2 を密着させる。ここで、AlGaInP 系半導体から成る多層体 X1a の劈開面 (110) と GaN 系半導体から成る多層体 Y2a の劈開面 (1-100) とが一致し、且つ AlGaInP 系半導体から成る多層体 X1a の導波路 1b と GaN 系半導体から成る多層体 Y2a の導波路 1b とが近接するよ

うにして、接着層 CNT 1, CNT 2 を密着させる。

【0090】

次に、約 300°C のフォーミングガス雰囲気中で、第 1, 第 2 の中間生成体 100, 200 全体を加熱することにより、接着層 CNT 1, CNT 2 の密着している部分を融着させ、一体化した接着層 CNT にする。

【0091】

次に、図 6 (b) に示すように、360 nm 以下の波長のレーザー光を支持基板 SUB 2 の裏面側より照射する。より好ましくは YAG レーザの 4 倍波 (波長 266 nm) を所定の集光レンズで絞り、高エネルギーの光にし、説明の便宜上、多数の矢印で示されているように、支持基板 SUB 2 の裏面側より照射する。

【0092】

波長 266 nm のレーザー光は、支持基板 (サファイア基板) SUB 2 中で殆ど吸収されずに透過し、GaN には僅かな浸透深さで吸収される。更に、支持基板 SUB 2 と GaN の間に大きな格子不整合があることから、GaN の接合部近傍の部分には極めて多くの結晶欠陥が存在する。このため、吸収された光は GaN の接合部近傍の部分で殆ど熱に変換され、接合部近傍の部分の GaN が急激に高温加熱されて、金属ガリウムと窒素ガスに分解する。

【0093】

そして、予め溝 R が形成されているため、溝 R における GaN 系半導体から成る多層体 Y2a の薄い部分が上述のガスの力を受けて崩落等し、溝 R を境にして分割された複数の GaN 系半導体から成る多層体 Y2a が形成される。

【0094】

次に、図 6 (c) に示すように、ガリウムの融点温度より高い約 40°C に第 1, 第 2 の中間生成体 100, 200 全体を加熱し、支持基板 SUB 2 を各多層体 Y2a から剥離する。

【0095】

すなわち、上述した高エネルギーの光を支持基板 SUB 2 の裏面側より照射した段階では、多層体 Y2a と支持基板 SUB 2 は、金属ガリウムによる弱い結合状態にあるため、ガリウムの融点温度より高い約 40°C の温度で全体的に加熱することでその結合状態を更に弱めて、支持基板 SUB 2 を各多層体 Y2a から剥離する。

【0096】

このように支持基板 SUB 2 を剥離すると、図 6 (c) に示すように、各多層体 Y2a の表面と、溝 R に面する接着層 CNT が露出する。

【0097】

次に、純水中で超音波洗浄することによって、上述の崩落等した部分を除去した後、約 3 分間、希塩酸中に浸すことで、各多層体 Y2a の露出した表面に残留している金属ガリウムを除去する。

【0098】

次に、図 7 (a) に示すように、各多層体 Y2a の表面 (n 型 GaN の面) に、チタン (Ti) 又は Au 若しくはこれらの積層から成るオーミック電極層 P2、n 型 GaAs 基板 SUB 1 の裏面に、AuGe の合金 (金とゲルマニウムの合金) から成るオーミック電極層 P1 を蒸着等によって夫々形成する。

【0099】

次に、図 7 (b) に示すように、GaN 系半導体から成る多層体 Y2a の劈開面である (1-100) 面に沿って、図 7 (a) に示されている一体化した中間生成体 100, 200 を劈開することによってレーザー共振器を形成し、更に溝 R の部分で、レーザー共振器面と垂直な方向に二次劈開することによって、図 4 に示したように、異なる波長のレーザー光を発する第 1, 第 2 の発光素子 1a, 2a を有し、第 2 の発光素子 2 の形成領域に比して第 1 の発光素子 1 の占有面積の方が大きく、且つ接着層 CNT が第 1, 第 2 の発光素子 1, 2 から露出して延在することでコモンアノードとして機能する構造を有する個々の半導体

レーザ装置LDを完成する。

【0100】

本実施例により作製される半導体レーザ装置LDによれば、上述のコモンアノードとして機能する接着層CNTの露出部分とオーミック電極層P1間に駆動電流を供給すると、第1のレーザ発振部1aに形成されたレーザ共振器の劈開面から波長650nmのレーザ光が放射され、接着層CNTの露出部分とオーミック電極層P2間に駆動電流を供給すると、第2のレーザ発振部2aに形成されたレーザ共振器の劈開面から波長405nmのレーザ光が放射される。

【0101】

そして、第1、第2のレーザ発振部1a、2aを、融着金属から成る接着層CNT1、CNT2によって融着するので、導波路1b、2bを極めて狭い間隔で近接させることができ、発光点間隔の極めて小さい半導体レーザ装置LDを提供することができる。

【0102】

また、図5(d)に示したように、第2の中間生成体200の作製工程において、完成時に第2のレーザ発振部2aとなる台状の多層体Y2aの部分と、その台状の多層体Y2aに隣接する溝Rとを予め形成しておくので、第1、第2の中間生成体100、200を接着層CNT1、CNT2によって融着させた後、図6(b)(c)に示したように、所定波長のレーザ光を照射して支持基板SUB2を剥離するだけで、接着層CNTの溝Rに面した部分を露出させることができる。

【0103】

このため、仮に溝Rを形成しておかないで、第1、第2の中間生成体100、200を接着層CNT1、CNT2によって融着させた後、所定波長のレーザ光を照射して支持基板SUB2を剥離した場合には、融着後の接着層CNTを電極として利用するために、例えば多層体Y2a側をエッチングして接着層CNTを部分的に露出させる等の極めて困難な処理工程を必要とするのに対し、本実施例の製造方法によれば、極めて容易に接着層CNTを部分的に露出させることができ、歩留まりの向上、量産性の向上等を実現することができる。

【0104】

また、図6(b)に模式的に示したように、支持基板SUB2の裏面側から所定波長のレーザ光を照射した際に崩落等する多層体2aの部分が薄くなることから、複数分割される各多層体Y2aに与える機械的ダメージを低減させることができる。

【0105】

このように、第2の中間生成体200に予め溝Rを形成しておくことにより多くの効果を得られる。

【0106】

なお、本実施例では、導波路1b、2bをリッジ導波路としているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、他の構造であってもよい。

【0107】

また、支持基板SUB2としてサファイア基板を用いた場合について説明したが、AlN基板、SiC基板、AlGaN基板を用いるようにしてもよい。

【0108】

また、絶縁膜1c、2cとして、SiO₂、ZrO₂、AlN等の絶縁材料によって適宜形成するようにしてもよい。

【0109】

また、融着金属CNT1、CNT2として、Au、In、Pdを適宜組み合わせて形成するようにしてもよい。

【実施例2】

【0110】

次に、第2の実施形態に係るより具体的な実施例を図8～図10を参照して説明する。なお、図8(a)は第1の中間生成体100の作製工程を模式的に表した断面図、図8(b)

b) ~ (d) は第2の中間生成体200の作製工程を模式的に表した断面図、図9(a) ~ (c) と図10(a) (b) は、第1, 第2の中間生成体100, 200から半導体レーザ装置LDを製造する工程を表した断面図と斜視図である。また、図8~図10において、図4及び図5~図7と同一又は相当する部分を同一符号で示している。

【0111】

本実施例により作製される半導体レーザ装置LDは、基本的に図5から図7に示した実施例により作製される半導体レーザ装置と同様の構造を有している。ただし、次に述べるように製造方法が異なっている。

【0112】

すなわち、本実施例の半導体レーザ装置LDの製造方法を述べると、まず、図8(a)に示す第1の中間生成体100と図8(d)に示す第2の中間生成体200を予め作製する。ここで、図8(a)に示す第1の中間生成体100は、図5(a)に示した中間生成体100と同じ構造に作製する。

【0113】

一方、第2の中間生成体200の作製工程を述べると、サファイア基板から成る支持基板SUB2上に、MOCVD法等により、n型GaN又はAlNから成るn型バッファ層2aa及びn型GaNから成るn型下地層2abと、InGaNから成る光吸収層STPとを積層し、その光吸収層STP上に、組成と膜厚等の異なったGaN系半導体より成る複数の半導体薄膜を積層することで、上述の多重量子井戸構造の活性層とクラッド層とを有したGaN系半導体から成る多層体Y2aを形成する。

【0114】

より具体的には、GaN(0001)基板SUB2上に、GaN又はAlNから成るn型バッファ層2aaを厚さ約数十nm程度で積層し、次に珪素(Si)をドーピングしてn型化したn型GaNから成るn型下地層2abを厚さ約5~15 μ mで積層し、次に、非発光性再結合中心として、カーボン(C)をドーピングしたIn_{0.5}Ga_{0.5}Nから成る光吸収層STPを積層し、次にn型Al_{0.08}Ga_{0.92}Nから成るn型クラッド層2acを厚さ約0.8 μ mで積層し、次にn型GaNから成るn型ガイド層2adを厚さ約0.2 μ mで積層し、次に、組成の異なるIn_xGa_{1-x}N(但し、0 \leq x)、例えばIn_{0.08}Ga_{0.92}NとIn_{0.01}Ga_{0.99}Nから成る井戸層とバリア層との多重量子井戸構造を有する活性層2aeを約数十nmの厚さで積層し、次に、Al_{0.2}Ga_{0.8}Nから成る電子障壁層2afを厚さ約0.02 μ mで積層し、次に、マグネシウム(Mg)をドーピングしてp型化したp型GaNから成るp型ガイド層2agを厚さ約0.2 μ mで積層し、次に、p型Al_{0.08}Ga_{0.92}Nから成るp型クラッド層2ahを厚さ約0.4 μ mで積層し、次にp型GaNから成るp型コンタクト層2aiを厚さ約0.1 μ mで形成することによって、GaN系半導体から成る多層体Y2aを形成する。

【0115】

次に、反応性イオンエッチング(RIE)によって、ストライプ状の導波路2bを形成するための領域を除いて多層体Y2aをエッチングし、p型クラッド層2ahが約0.05 μ m程度の厚さとなる深さまでエッチングすることによって、〈1-100〉方向に沿ったストライプ状のリッジ構造を有する導波路2bを複数個形成する。

【0116】

次に、多層体Y2aの各導波路2b間の所定領域をエッチングすることにより、図8(c)に示すように、光吸収層STPが除かれてn型下地層2abに達する溝Rを形成し、次に、p型コンタクト層2ai以外の領域にSiO₂から成る絶縁膜2cを形成して絶縁被覆する。

【0117】

次に、図8(d)に示すように、p型コンタクト層2aiと絶縁膜2cの全面に、パラジウム(Pd)又は金(Au)若しくはこれらの積層から成るオーミック電極層2dを厚さ約200nmで形成することによって、p型コンタクト層2ahとオーミック電極層2cとを電氣的に接続させ、次に、オーミック電極層2dの全面に、融着金属として金(Au)

から成る接着層CNT2を形成することによって、第2の中間生成体200を作製する。

【0118】

次に、図9及び図10に示す工程により、予め作製した中間生成体100、200から半導体レーザ装置LDを製造する。

【0119】

まず、図9(a)に示すように、第1、第2の中間生成体100、200に形成されている導波路1b、2bを対向させて接着層CNT1、CNT2を密着させる。ここで、AlGaInP系半導体から成る多層体X1aの劈開面(110)とGaN系半導体から成る多層体Y2aの劈開面(1-100)とが一致し、且つ多層体X1aの導波路1bと多層体Y2aの導波路2bとが近接するようにして、接着層CNT1、CNT2を密着させる。

【0120】

次に、約300°Cのフォーミングガス雰囲気中で、第1、第2の中間生成体100、200全体を加熱することにより、接着層CNT1、CNT2の密着している部分を融着させ、一体化した接着層CNTを生じさせる。

【0121】

次に、図9(b)に示すように、YAGレーザの2倍波(波長532nm)を所定の集光レンズで絞り、高エネルギーの光にして、説明の便宜上、多数の矢印で示されているように、支持基板SUB2の裏面側より照射する。

【0122】

波長532nmのレーザ光は、支持基板SUB2とバッファ層2aa及びn型下地層2ab中を透過して光吸収層STPに到達し、レーザ光によって光吸収層STPが加熱分解されることにより、n型下地層2abと各多層体Y2a間の結合力が低下する。

【0123】

そこで、図9(c)に示すように、光吸収層STPを境にして支持基板SUB2を剥離することにより、バッファ層2aa及びn型下地層2abと、溝Rにおける接着層CNT2とオーミック電極層2dと絶縁膜2cとを支持基板SUB2に付随させて取り除き、各多層体Y2aの表面と溝Rに面している接着層CNTとを露出させる。

【0124】

次に、図10(a)に示すように、蒸着等によって、各多層体Y2aの表面(n型GaNの面)に、チタン(Ti)又はAu若しくはこれらの積層から成るオーミック電極層P2を形成すると共に、n型GaAs基板SUB1の裏面に、AuGeの合金(金とゲルマニウムの合金)から成るオーミック電極層P1を形成する。

【0125】

次に、図10(b)に示すように、GaN系半導体から成る多層体Y2aの劈開面である(1-100)面に沿って、図10(a)に示されている一体化した中間生成体100、200を劈開することによってレーザ共振器を形成し、更に溝Rの部分で、レーザ共振器面と垂直な方向に二次劈開することによって、基本的図4に示したのと同様の構造を有する個々の半導体レーザ装置LDを完成する。

【0126】

以上説明したように本実施例の製造方法及び該製造方法により作製される半導体レーザ装置LDによれば、上述した第1の実施形態と同様の効果が得られる他、製造工程において、第2の中間生成体200側に予め光吸収層STPを形成しておき、支持基板SUB2の裏面側から所定波長のレーザ光を照射して光吸収層STPを分解させるので、支持基板SUB2と共に下地層2abを除去することができる。

【0127】

これにより、多層体Y2aにおける活性層及びガイド層への光の閉じ込めが向上し、レーザ光の放射ビームの品質が向上する。

【0128】

また、支持基板SUB2の裏面側から照射するレーザ光には、下地層2abを透過するようなレーザ光を用いるため、支持基板SUB2は下地層2abと同一の材料、例えばGaN

を用いることができる。このため、さらに高品質な多層体 Y2a を形成することが可能となる。

【0129】

また、図 8 (d) に示した第 2 の中間生成体 200 に予め溝 R を形成する際、支持基板 SUB 2 から光吸収層 STP までの厚みに較べて、支持基板 SUB 2 から溝 R の底面までの厚みの方が小さくなるように、溝 R の深さを調整しておくこと、その溝 R によって薄くなった下地層 2ab の部分から光吸収層 STP が予め取り除かれることとなる。このため、支持基板 SUB 2 の裏面側から所定波長のレーザ光の照射及び支持基板 SUB 2 の剥離工程において、溝 R における下地層 2ab を破碎等することなく、溝 R に面している接着層 CNT 1 を露出させることができるため、歩留まりの向上を図ることができる等の効果が得られる。

【0130】

なお、本実施例では、導波路 1b, 2b をリッジ導波路としているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、他の構造であってもよい。

【0131】

また、支持基板 SUB 2 として GaN 基板を用いた場合について説明したが、サファイア基板、AlN 基板、SiC 基板、AlGaIn 基板を用いるようにしてもよい。

【0132】

また、絶縁膜 1c, 2c として、SiO₂、ZrO₂、AlN 等の絶縁材料によって適宜形成するようにしてもよい。

【0133】

また、融着金属 CNT 1, CNT 2 として、Au、In、Pd を適宜組み合わせて形成するようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

【0134】

【図 1】第 1 の実施形態により作製される半導体レーザ装置の構造を模式的に表した図である。

【図 2】第 1 の実施形態の半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

【図 3】第 2 の実施形態により作製される半導体レーザ装置の構造及びその製造方法を模式的に表した図である。

【図 4】第 1 の実施例により作製される半導体レーザ装置の構造を模式的に表した図である。

【図 5】第 1 の実施例の半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

【図 6】更に図 4 に示した半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

【図 7】更に図 4 に示した半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

【図 8】第 2 の実施例の半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

【図 9】更に第 2 の実施例の半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

。【図 10】更に第 2 の実施例の半導体レーザ装置の製造方法を模式的に表した図である。

【符号の説明】

【0135】

LD…半導体レーザ装置

1a…第 1 のレーザ発振部

2a…第 2 のレーザ発振部

X1a…第 1 の多層体

Y2a…第 2 の多層体

SUB 1…半導体基板

SUB 2…支持基板

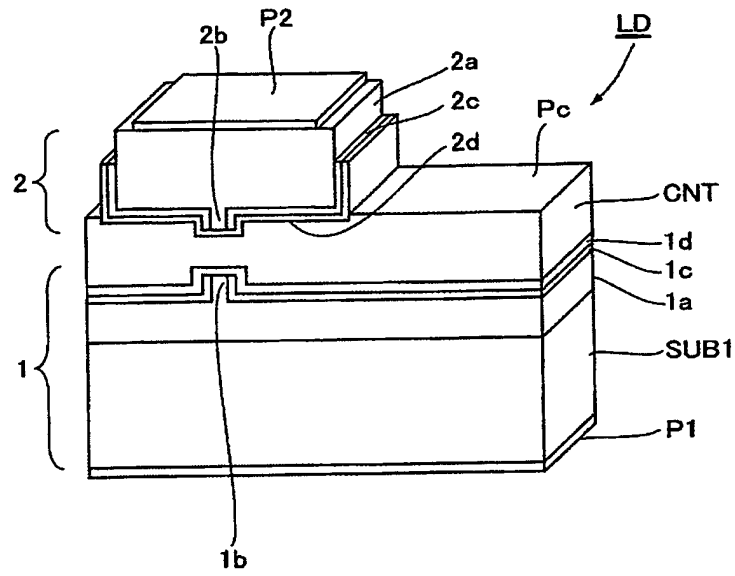
CNT 1, CNT 2, CNT…接着層



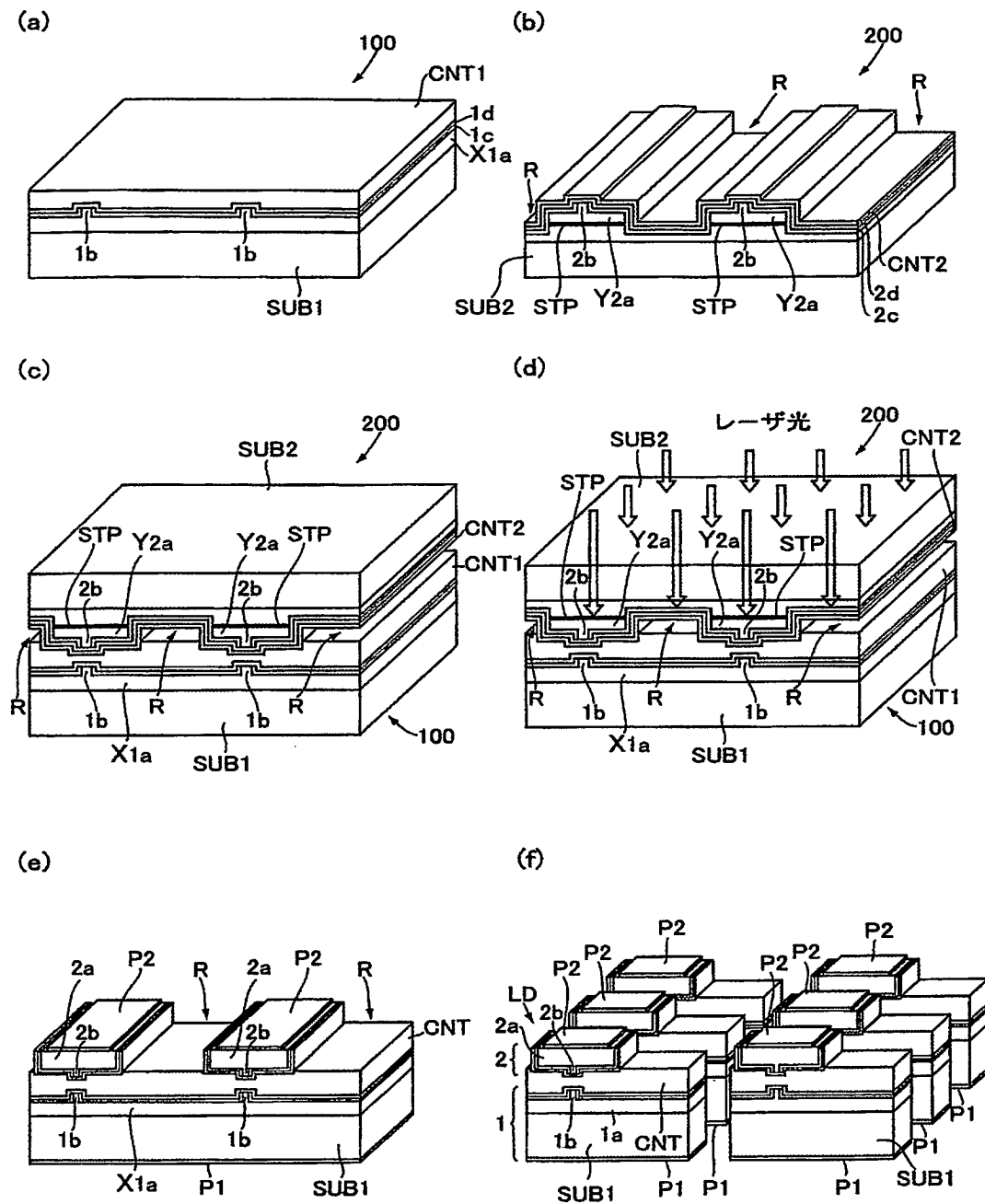
R...溝

S T P...光吸収層

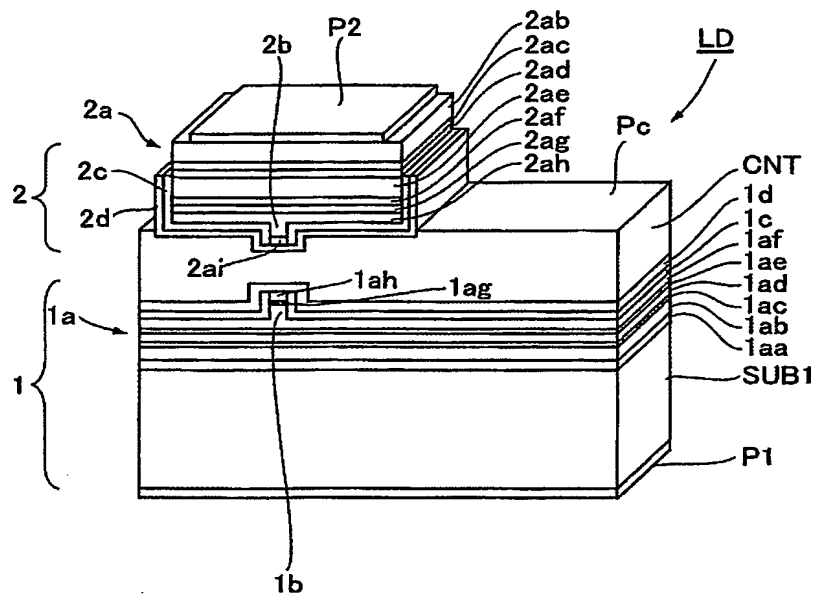
【書類名】 図面
【図 1】



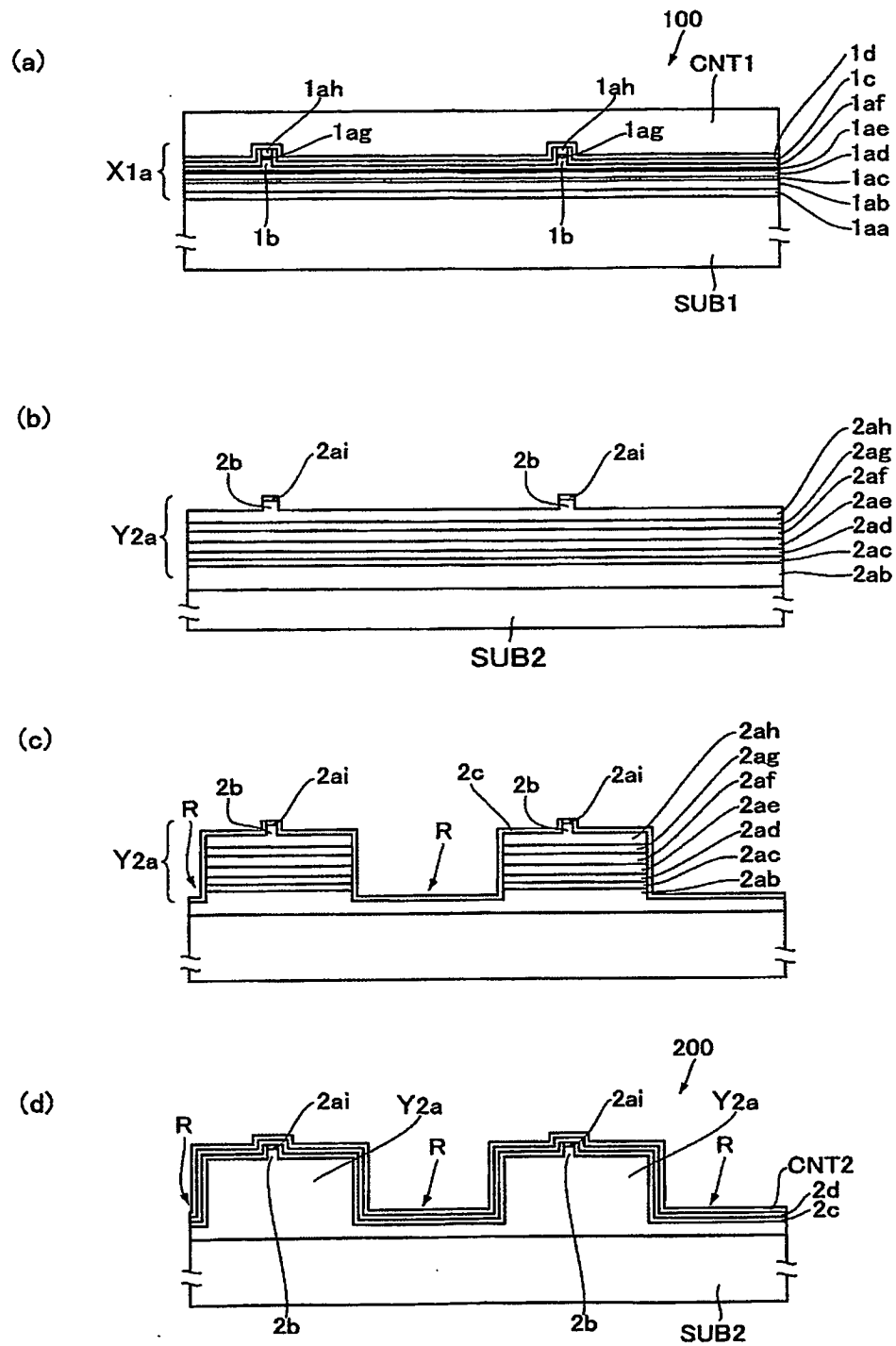
【図 3】



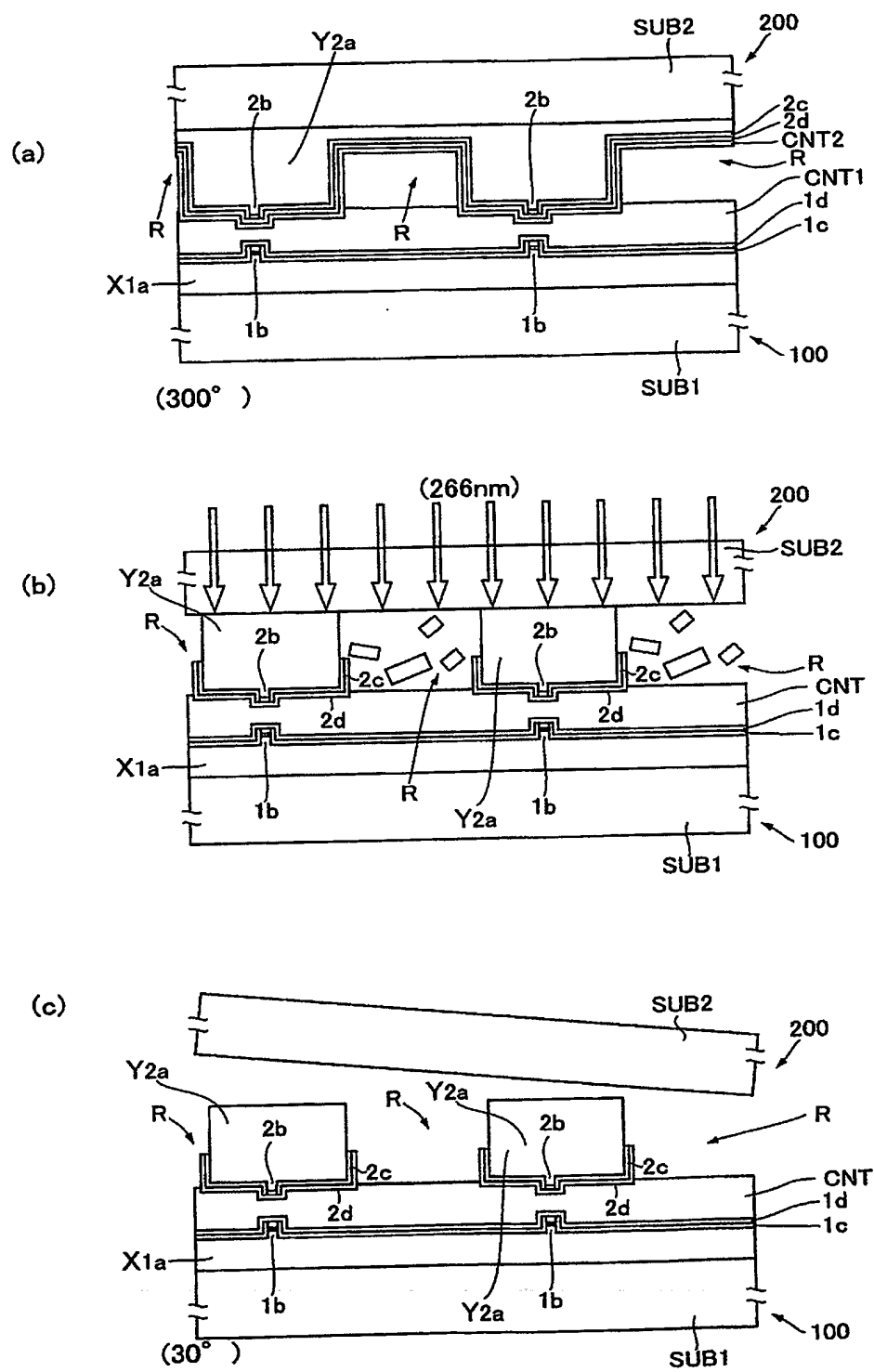
【図 4】



【図 5】

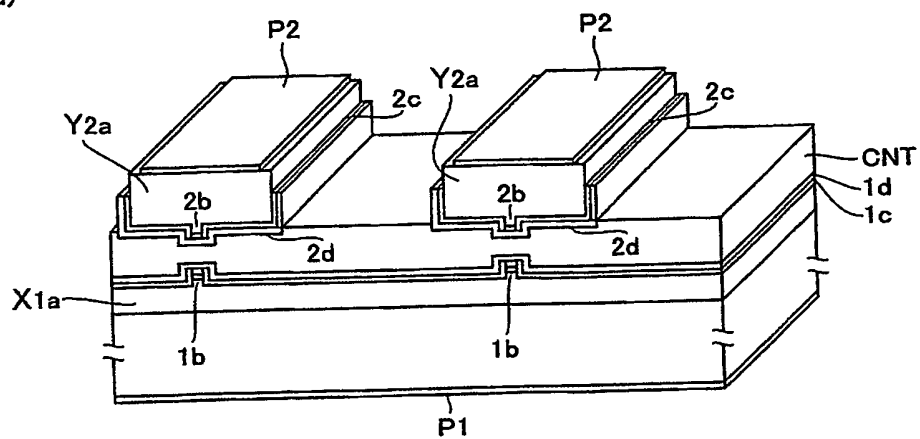


【図 6】

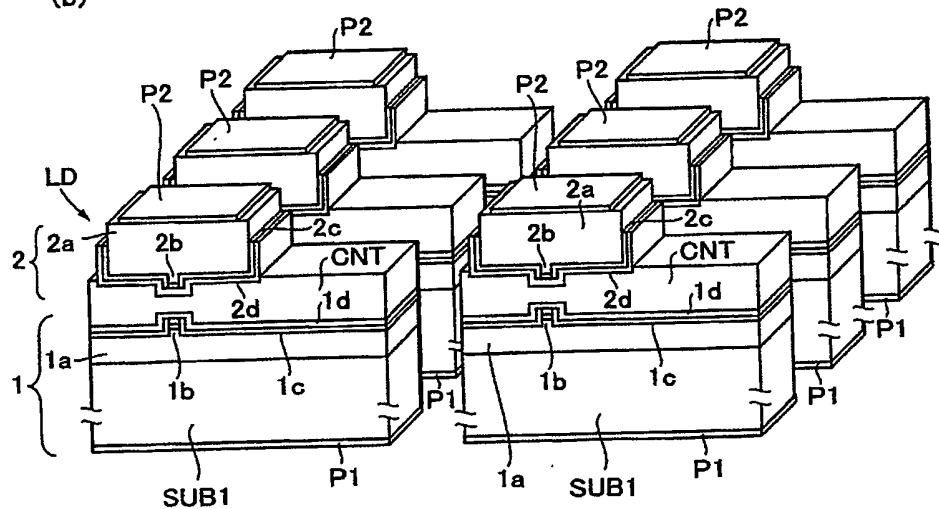


【図 7】

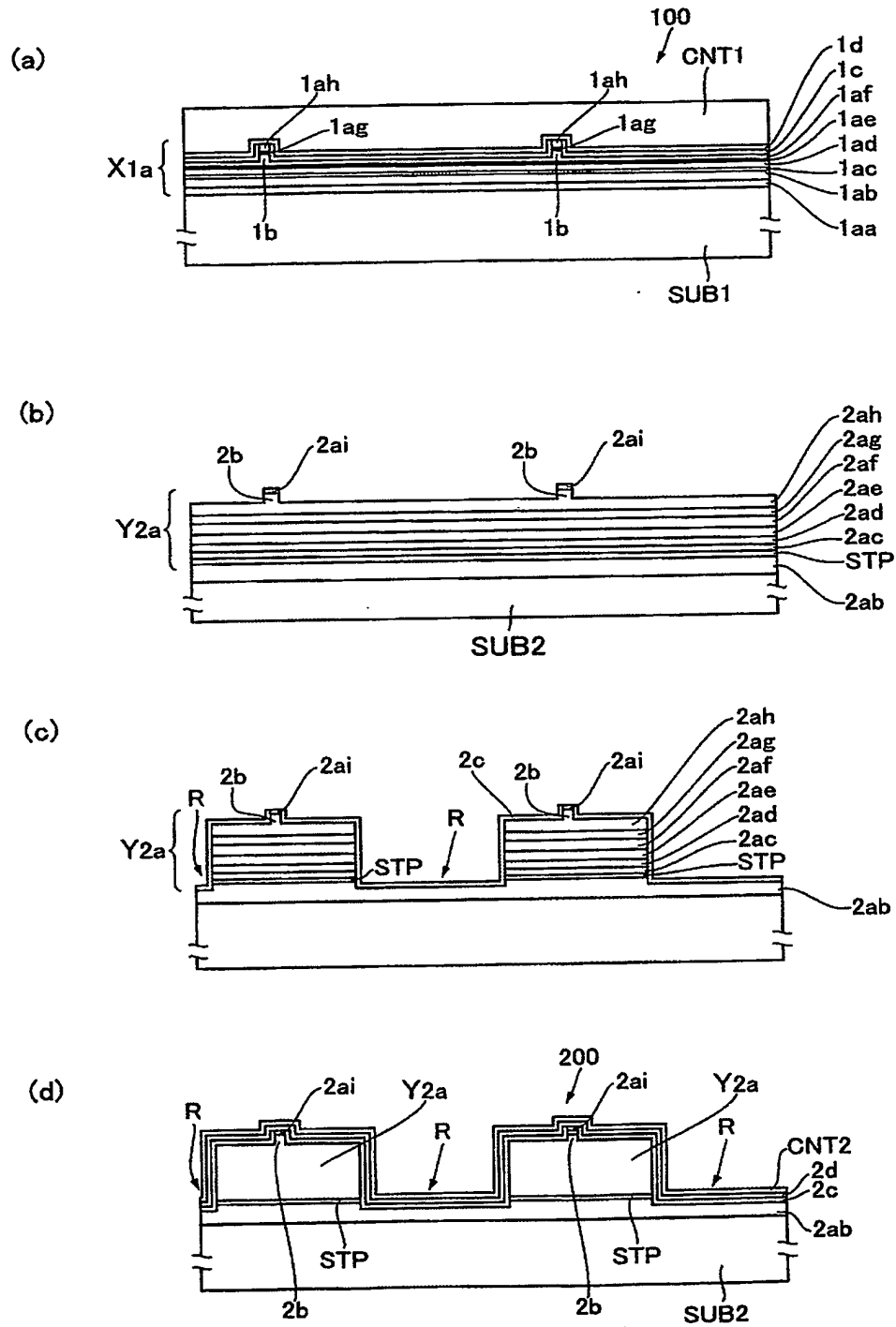
(a)



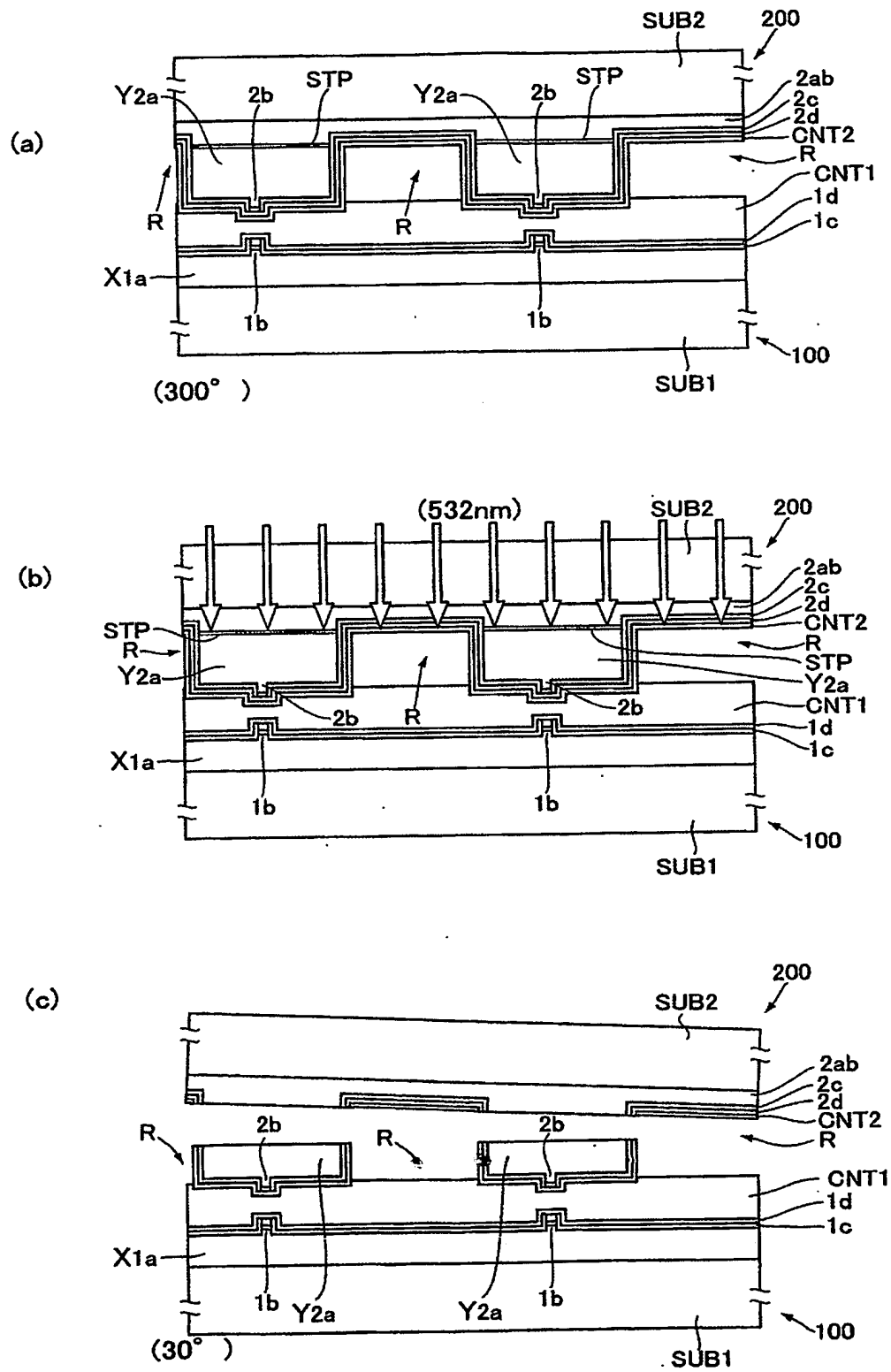
(b)



【図 8】

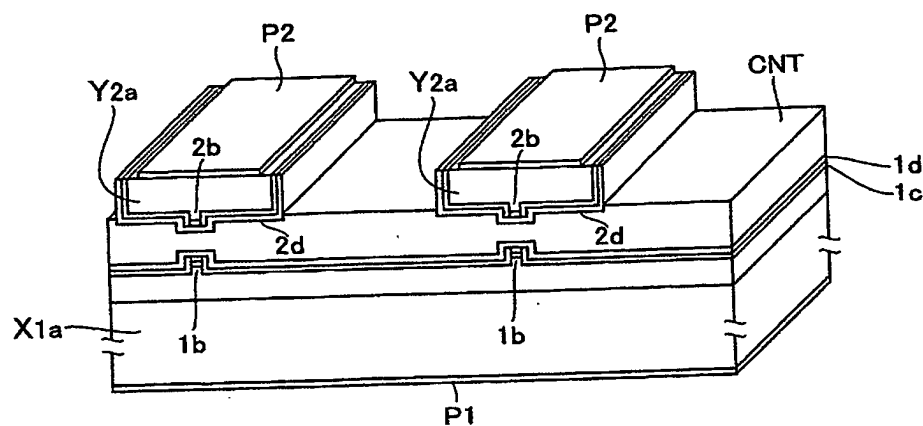


【図 9】

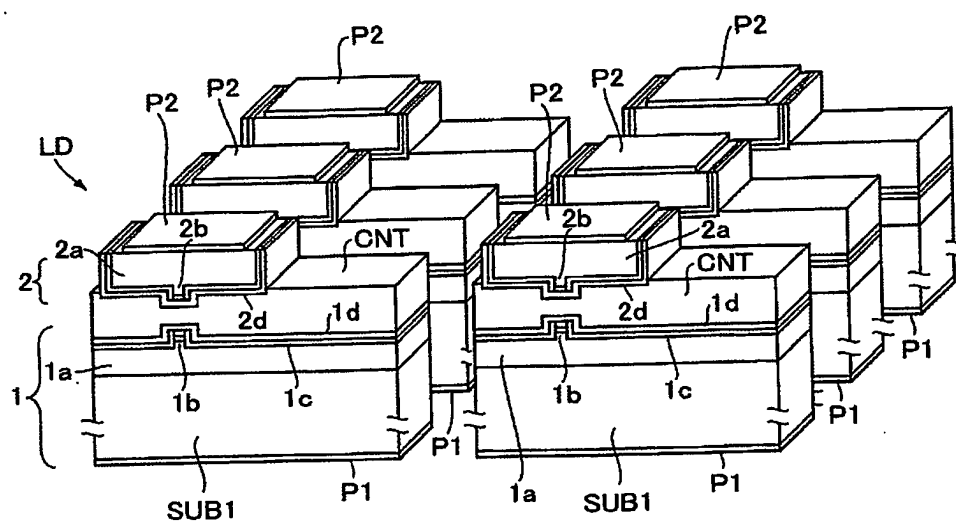


【図 10】

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 量産性等に優れた多波長半導体レーザ装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 半導体基板 SUB1 上に多層体から成る第 1 のレーザ発振部 1a と金属の接着層とを形成した第 1 の中間生成体と、支持基板上に第 1 のレーザ発振部 1a より小形の多層体から成る第 2 のレーザ発振部 2a とそれに隣接する溝とを形成して金属から成る接着層を形成した第 2 の中間生成体とを作製し、導波路 1b, 2b を近接させて第 1, 第 2 の中間生成体の接着層同士を融着させ、一体化した接着層 CNT を生じさせることによって、第 1, 第 2 のレーザ発振部 1a, 2a を固着させた後、第 2 のレーザ発振部 2a から支持基板を剥離することにより、接着層 CNT を部分的に露出させ、該露出した接着層 CNT を共通電極とした半導体レーザ装置 LD を製造する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-407965
受付番号	50302011514
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成15年12月 8日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年12月 5日

特願 2 0 0 3 - 4 0 7 9 6 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 0 1 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 1 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都目黒区目黒 1 丁目 4 番 1 号

氏 名

パイオニア株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.